

特集

電子機器の小型化，高性能化の決め手

最新実装技術と PCB CADの動向

電子機器の小型化，高性能化のためには，部品の小型化や高集積化のみならず，それらが搭載されるプリント基板の高密度化が重要になります。市場で競争力のある製品をつくり上げるためには，回路設計だけでなく，実装の技術も要求されます。小さな部品を高い密度で実装することは，決して容易なことではないのです。今回の特集では，実装技術をテーマに，PCB CADや部品パッケージングの最新動向から基板や実装の基礎知識について解説します。また，特集にあわせて，付属CD-ROMには，試用版のPCB CADを収録しています。

CONTENTS

第1章 絵解き 超小型電子機器時代の実装技術	52
傳田精一	
第2章 Windows版PCB CADの現状と動向	56
城野幸男	
第3章 電子回路基板の種類と材料技術の動向	64
万永正信	
第4章 実装技術の基本	70
長谷川正行	
第5章 各社PCB CAD紹介	80
OrCAD Layout Plus Ver6.41 / PROVIDENCE System Designer / ACCEL EDAシリーズ / Vanguard PCBバック / PADS Power PCB / ICAD / PCB for Windows / PCB-Process Builder	